



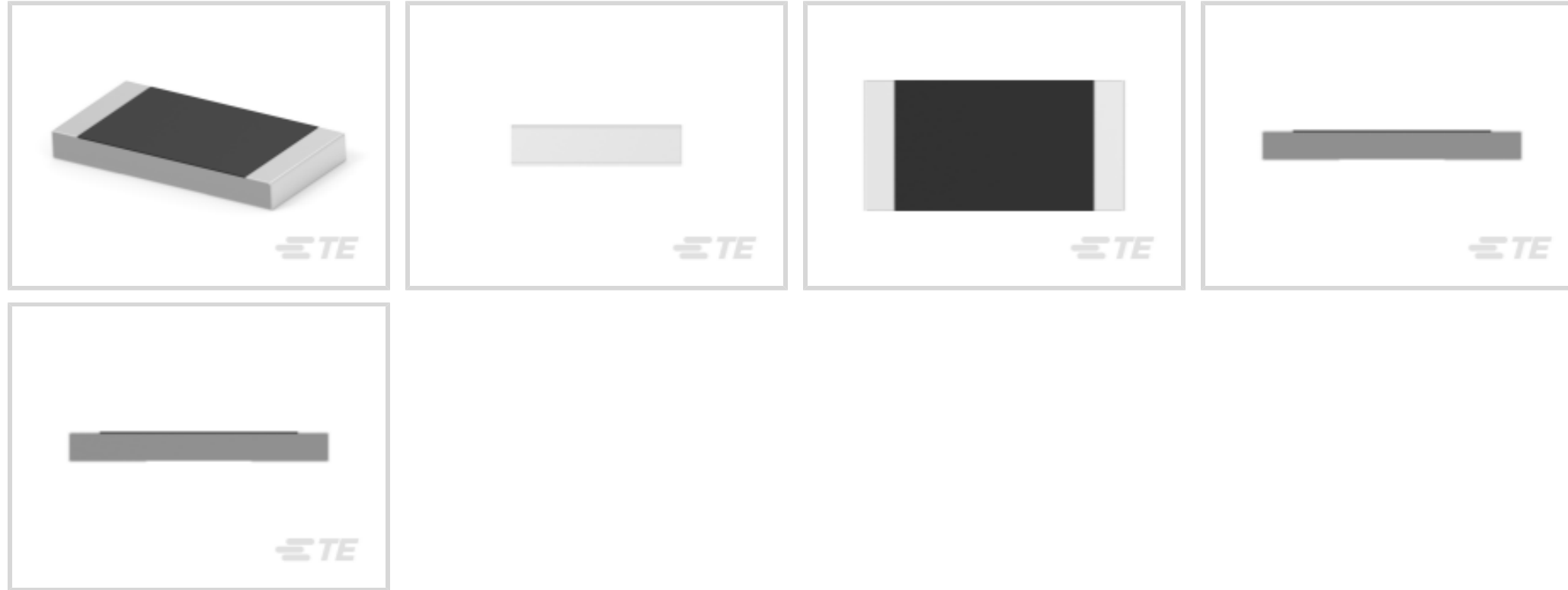
CGS | CGS TLM

TE 内部编号 3-2176157-8

.1 Ω , Foil, Current Sensing Resistor, 1 %, 2 Termination, 2010, Taped & Reeled, .75 W, ± 50 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, Solder, Height .022 in [.55 mm], CGS TLM

[在 TE 官网查看>](#)

无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器 > 金属芯片电阻器：电流感应



电阻器类型: **电流传感电阻器**

端接数量: 2

封装尺寸代码: 2010

封装方法: **卷带和卷轴**

无源元件容差: 1 %

[所有 金属芯片电阻器：电流感应 \(152\)](#)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	电流传感电阻器
封装尺寸代码	2010
元件类型	箔片

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

无源元件容差	1 %
电阻等级	最多 1 k Ω
电阻值	.1 Ω
额定功率	.75 W

端接特性

端接数量	2
------	---



表面贴装电阻器端接类型

焊接

尺寸

产品高度

.55 mm[.022 in]

产品长度

5 mm[.197 in]

产品宽度

2.5 mm[.098 in]

使用环境

温度系数

 ± 50 ppm/ $^{\circ}\text{C}$

包装特性

封装方法

卷带和卷轴

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

回流焊接可达到 260 $^{\circ}\text{C}$

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

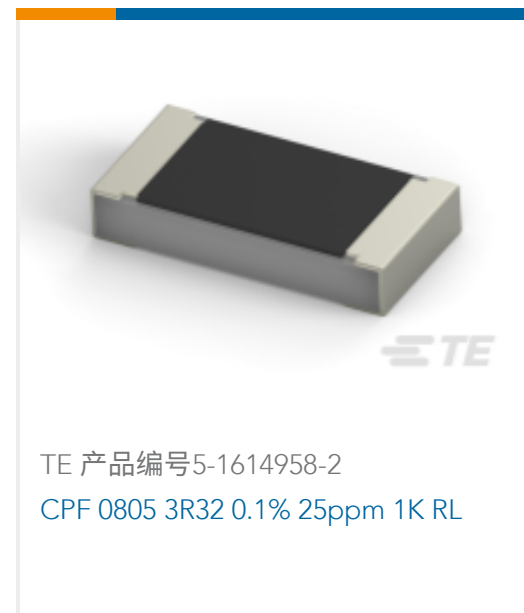
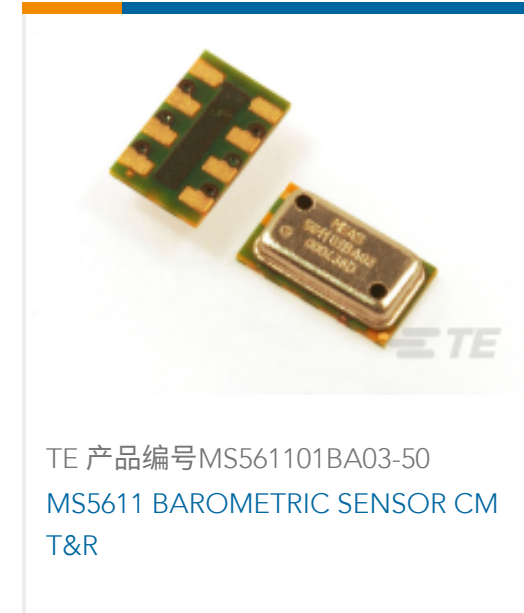
配套部件



该系列中的其他产品 | CGS TLM



客户还购买了





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2176157-8_BA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2176157-8_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2176157-8_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[SMD Current Sense Metal Chip Resistor](#)

英文版本